不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS****监查1** |
| **受审核方** | **成都蒲然科技有限公司** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **陪同人员** | **邵猷** |
| **不符合事实描述:****现场查看未能提供特殊过程（芯片焊接过程）的过程能力确认记录。****上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**